DIVA Labs.

ECR (Engineering Change Request)

Proposed Change :
☐1. Design modification 設計修改 ☐2. Material change 材料變更 ☐3. Manufacturer change 製造商變更
☐4. Factory change 工廠變更 ☐5. Process sequency change 工序變更 ☐6. Equipment / Tooling change 設備 / 模具變更
☐7. Process / Method / Condition change 加工流程/方法 / 條件變更 ☐8.Add second source 新增替代料
■9. Others 其他：_____料階變更_____

Initiator : Kane 0324 1545

Reason for Change : 變更物料料階

EC No : EC2603100

Model / Part No. : PC270522R

Issue Date : 2026/3/24

Requester Dept. : DV11R002

Implementation Type : ■1. Immediately Change 立即切換 ☐2. Running Change 自然切換 ☐3. Other 其他：_____

Customer Approval : (confirmed by PM) ☐ Needed ■ Not needed

Material Change Description (Please add pages as needed if the provided space is insufficient.)
物料變更說明（如不敷使用請逕行增頁）

No.	Subassembly		Part No.	Description	Q'ty	Location	Stock	Remark
1	2AAD6810031	B	3KH00089300	H WIRE*4 (2530-04&2530-08,500mm)	1		544	Delete
		A						
2	2AAD6810023	B						
		A	3KH00089300	H WIRE*4 (2530-04&2530-08,500mm)	1		544	
3	2AAD6810031	B	3MD364ME040	MAIN BRACKET (27")	1		5	Delete
		A						

Comments 會簽意見

R&D		Department 會簽部門								Approval
Initiator	Initiator's Direct Supervisor	DQE	PM	Sales	PE	PMC	SCM	PD	QA	R&D Director
Kane 0324 1050	Michael 0324 1510 Fernish 0324 1100		0324 1106	0324 1105	0324 1100	Tony 0324	3/24	0324 1150	0324	Michael 0326 1510

ECR (Engineering Change Request)

Material Change Description (Please add pagesor row as needed if the provided space is insufficient.)
物料變更說明（如不敷使用請逕行增頁或增列）

No.	Subassembly		Part No.	Description	Q'ty	Location	Stock	Remark
4	2AAD6810023	B						
		A	3MD364ME040	MAIN BRACKET (27")	1		5	
5	2AAD6810031	B	3MDL32ME080	INSULATOR (15"I/O BRACKET,30*10.1*t0.25)	-1	Tony 0324 1200	>46	Delete
		A						
6	2AAD6810039	B						
		A	3MDL32ME080	INSULATOR (15"I/O BRACKET,30*10.1*t0.25)	-1	Tony 0324 1200	>46	

ECR (Engineering Change Request)

Engineering Change Assessment Item List 工程變更評估項目清單			
Document	Confirm	Authorized Dept.	Remark
1. Application for Revision of Specification or Drawing(s) for delivery 是否有修改交貨的規格或圖面	☐Yes ☑No need	RD	
2. Standards or Regulatories Impact 是否有評估適用之標準或主管機關之相關法規的申請	☐Yes ☑No need	DQE	無影响
3. Change point of PCB mounting PCBA插件位置是否變更	☐Yes ☑No need	RD	
4. PCBA Process Changes PCBA製程是否變更	☐Yes (Continue checking below) ☑No	PE	無影响
4-1) Change of Reflow temperature 迴焊溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-2) Change of bonding temperature 膠合溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-3) Change of Manual Soldering temperature 人工手焊工具之溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-4) Change of storage condition after protection humidity package 防潮包裝完成後的儲存條件是否變更	☐Yes ☐No need		
5. Reliability test report (Test result and data) 是否有可靠性測試報告（測試結果及數據）	☐Yes ☑No need	DQE	無影响
6. Process FMEA（Medical only） 是否有進行製程失效模式與效應分析	☐Yes ☑No need	PE	無影响
7. Design FMEA （Medical only） 是否有進行設計失效模式與效應分析	☐Yes ☑No need	RD	
8. Risk Management（Medical only） 是否有進行風險管理評估	☐Yes ☑No need	RD	
9. Change points due to the modification 是否此修改會延伸導致其他變更點	☐Yes ☑No need	RD	

ECR (Engineering Change Request)

Engineering Change Assessment Item List
工程變更評估項目清單

Document	Confirm	Authorized Dept.	Remark
10. Initial Supply Control implements plan or result. 是否有實施供料控制評估	☑Yes ☐No need	PMC	
10-1) Confirm the work order or order number or date for the implementation start of the engineering change. 確認工程變更開始實施之工單或訂單號碼或日期。	☑Yes ☐No need		工單100770, 2026.6.7 工單100908, 2026.9.8
10-2) Coordinate the handling methods for related products and materials. 協調相關產品及材料處理方法。	☑Yes ☐No need		
10-3) Arrange the production schedule. 處理生產日程之安排。	☑Yes ☐No need		
10-4) Control the changed materials. 變更材料之管制。	☐Yes ☑No need		
10-5) Establish relevant execution control records for EC materials, register traceability data for each material. 建立有關工程變更物料之相關執行管控記錄、登錄各項物料追溯性資料。	☑Yes ☐No need		EC-2603100追縱.
11. Training Requirement 若此一變更影響製程或檢驗，是否需要再做人員訓練	☐Yes ☑No need	PE	無影响
12-1. Modification contents (For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件（如下） ☐ QC control plan ☐ Service Manual ☐ Others	☐Yes ☑No need	QA	無影响
12-2. Modification contents (For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件（如下） ☐ SIP ☐ SOP ☐ Others	☐Yes ☑No need	PE	無影响
12-3. Modification contents (For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件（如下） ☐ MDF ☐ DMR ☐ Approval Sheet ☐ Engineering Spec ☐ Others	☐Yes ☑No need	RD / DQE	無影响

設計變更審查會議紀錄

時間	2026/3/23	地點	801	主席	Morris

參與人員:

Kane、Morris、Tony、Killy、Han

討論與決議事項：

PC270522R、PC270529R兩機種在M-BOM中需更改

物料料階，內容如以下表格。麻煩請幫忙ECR變更

PC270522R

Subassembly		Part.No	Description	Q'ty
2AAD6810031	B	3KH00089300	H WIRE*4 (2530-04&2530-08,500mm)	1
	A			
2AAD6810023	B			
	A	3KH00089300	H WIRE*4 (2530-04&2530-08,500mm)	1
2AAD6810031	B	3MD364ME040	MAIN BRACKET (27")	1
	A			
2AAD6810023	B			
	A	3MD364ME040	MAIN BRACKET (27")	1
2AAD6810031	B	3MDL32ME080	INSULATOR (15"I/O BRACKET,30*10.1*t0.25)	2
	A			
2AAD6810039	B			
	A	3MDL32ME080	INSULATOR (15"I/O BRACKET,30*10.1*t0.25)	2

PC270529R

Subassembly		Part.No	Description	Q'ty
2AAD6560131	B	3KH00089300	H WIRE*4 (2530-04&2530-08,500mm)	1
	A			
2AAD6560123	B			
	A	3KH00089300	H WIRE*4 (2530-04&2530-08,500mm)	1
2AAD6560131	B	3MDL19RB110	RUBBER FOOT (L20*W15*t8)	2
	A			
2AAD6560123	B			
	A	3MDL19RB110	RUBBER FOOT (L20*W15*t8)	2
2AAD6560131	B	3MDL19RB180	RUBBER FOOT (L14.5*W7*t5)	2
	A			
2AAD6560123	B			
	A	3MDL19RB180	RUBBER FOOT (L14.5*W7*t5)	2

變更號碼：EC
變更機種名稱：PC270522R、PC270529R
設計變更原因：物料料階錯誤
設計變更描述：變更物料料階
導入時程：Normal
客戶審查：Not need

研發評估：

單位	審查內容	附加文件
EE	經評估變更與軟體設計無關,不會造成軟體安全性影響	無
FW	經評估變更與軟體設計無關,不會造成軟體安全性影響	無
ME	經評估變更與軟體設計無關,不會造成軟體安全性影響	無
SW	經評估變更與軟體設計無關,不會造成軟體安全性影響	無
DQE	經評估變更與軟體設計無關,不會造成軟體安全性影響	無

結論：

功能	設計變更內容無關功能影響	
性能	設計變更內容,無關產品性能影響	
可用性	無影響,沒有使用上的風險	
安全性	組裝方式沒有改變, 沒有安全性風險,	
法規	經審查,沒有影響法規內容	

人員簽到：Kane Tony. Kelly Han . M.Pan